

单 N 沟道 MOSFET

ELM43400CB-S

<http://www.elm-tech.com>

■概要

ELM43400CB-S 是 N 沟道低输入电容,低工作电压,低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=30V$
- $I_d=5.8A$
- $R_{ds(on)} = 27m\Omega$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 32m\Omega$ ($V_{gs}=4.5V$)
- $R_{ds(on)} = 40m\Omega$ ($V_{gs}=2.5V$)

■绝对最大额定值

如没有特别注明时, $T_a=25^\circ C$

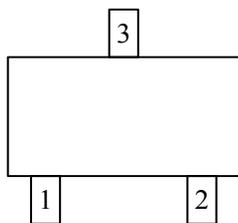
项目	记号	规格范围	单位	备注	
漏极 - 源极电压	V_{ds}	30	V		
栅极 - 源极电压	V_{gs}	± 12	V		
漏极电流 (定常)	I_d	$T_a=25^\circ C$	5.8	A	
		$T_a=70^\circ C$	4.9		
漏极电流 (脉冲)	I_{dm}	20	A	2	
容许功耗	P_d	1	W	3	
保存温度范围	T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ C$		
结合部温度范围	T_j	$-55 \sim 150$			

■热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
结合部 - 周边环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	125	$^\circ C/W$	1
		$t \leq 10s$	85	$^\circ C/W$	

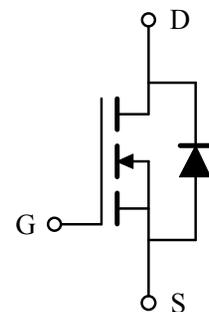
■引脚配置图

SOT-23(俯视图)



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	SOURCE
3	DRAIN

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM43400CB-S

<http://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, Ta=25℃

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BVdss	Id=250μA, Vgs=0V	30	-	-	V	
栅极接地时漏极电流	Idss	Vds=24V, Vgs=0V	-	-	1	μA	
		Vds=24V, Vgs=0V, Ta=55℃	-	-	5		
栅极漏电流	Igss	Vds=0V, Vgs=±12V	-	-	±100	nA	
栅极阈值电压	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=250μA	0.5	-	1.2	V	
漏极 - 源极导通电阻	Rds(on)	Vgs=10V, Id=5.8A	-	-	27	mΩ	2
		Vgs=4.5V, Id=5.0A	-	-	32		
		Vgs=2.5V, Id=4.0A	-	-	40		
正向跨导	Gfs	Vds=5V, Id=5A	-	25	-	S	
二极管正向压降	Vsd	Is=1A, Vgs=0V	-	-	1.2	V	2
寄生二极管最大连续电流	Is	Vgs=Vds=0V, Force current	-	-	5.8	A	1, 4
动态特性							
输入电容	Ciss	Vgs=0V, Vds=15V, f=1MHz	-	860	-	pF	
输出电容	Coss		-	84	-	pF	
反馈电容	Crss		-	70	-	pF	
栅极电阻	Rg	Vgs=0V, Vds=0V, f=1MHz	-	1.5	-	Ω	
开关特性							
总栅极电荷 (4.5V)	Qg	Vgs=4.5V, Vds=15V, Id=5.8A	-	11.5	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Qgs		-	1.6	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Qgd		-	2.9	-	nC	
导通延迟时间	td(on)	Vgs=10V, Vds=15V, Id=5A Rgen=3Ω	-	5	-	ns	
导通上升时间	tr		-	47	-	ns	
关闭延迟时间	td(off)		-	26	-	ns	
关闭下降时间	tf		-	8	-	ns	

备注:

1. 测试值是安装在表面为1平方英寸2盎司铜箔的FR-4基板的状态下取得的值;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度≤300μ秒和占空比≤2%;
3. 功耗受150℃结合部温度限制;
4. 数据在理论上是与Id和Idm相同的, 而在实际应用中是受到总功率损耗限制的。

单 N 沟道 MOSFET

ELM43400CB-S

<http://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

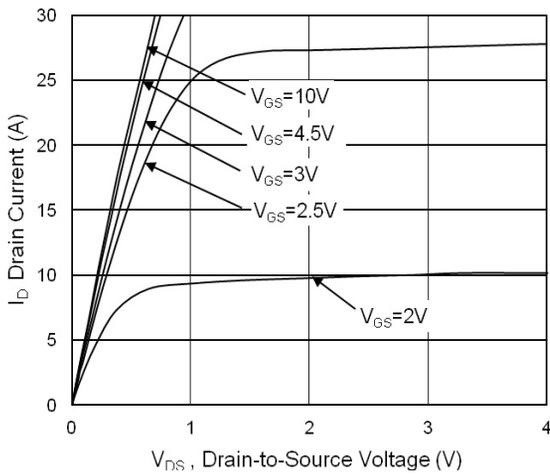


Fig.1 Typical Output Characteristics

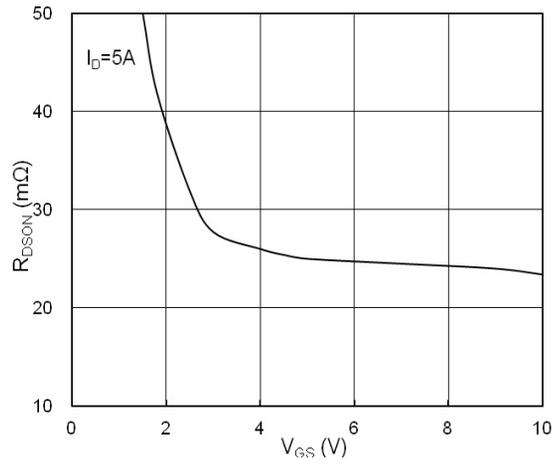


Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source

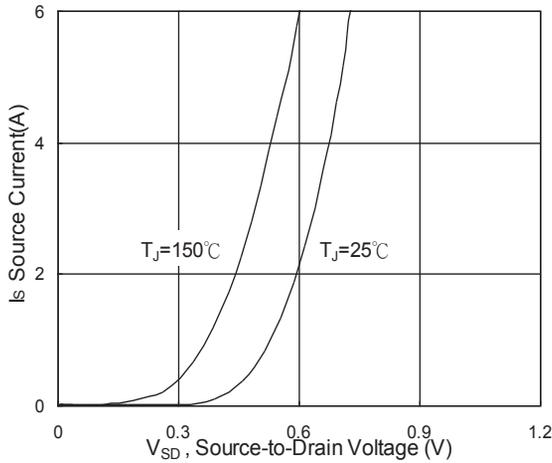


Fig.3 Source Drain Forward Characteristics

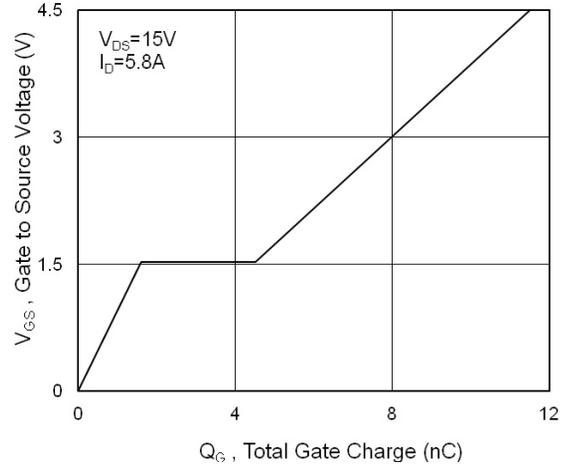


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

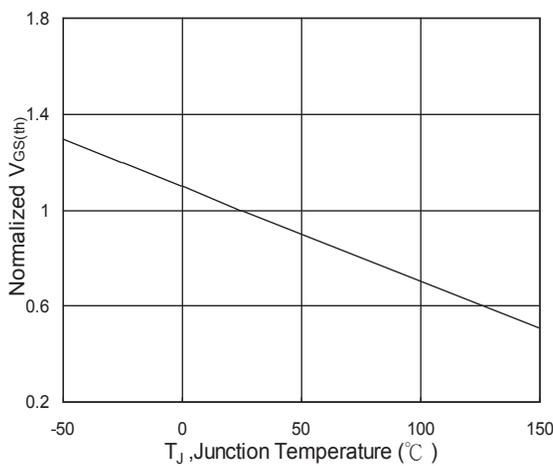


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs. T_J

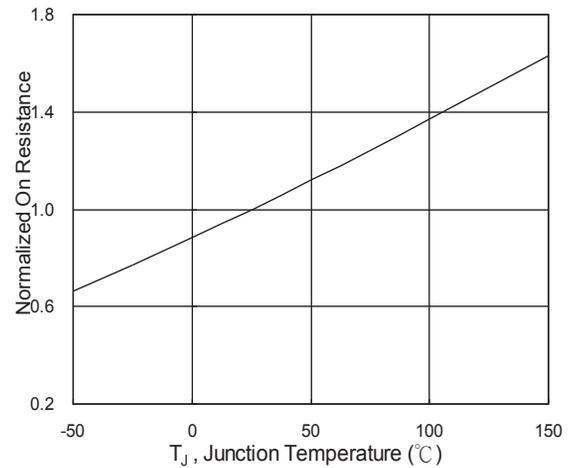


Fig.6 Normalized R_{DSON} vs. T_J

单 N 沟道 MOSFET

ELM43400CB-S

<http://www.elm-tech.com>

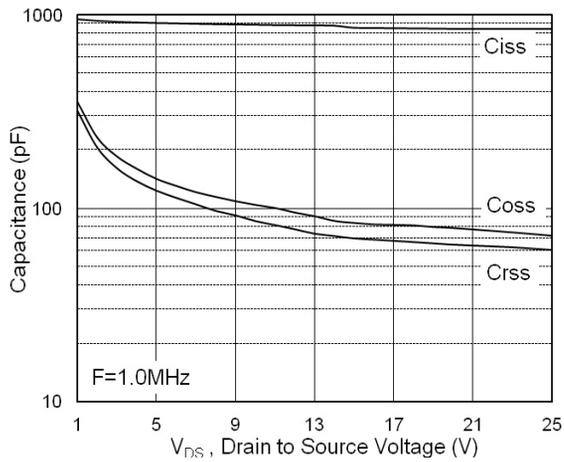


Fig.7 Capacitance

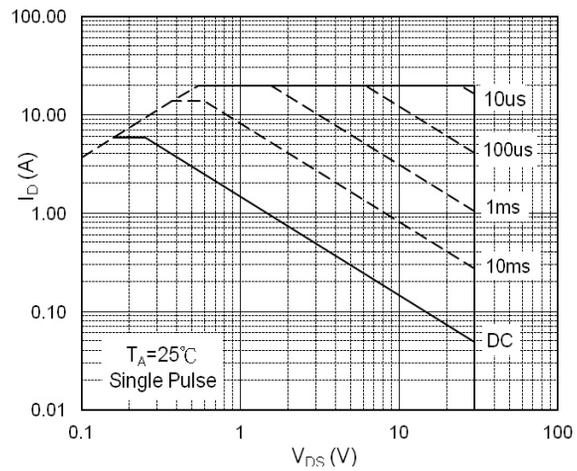


Fig.8 Safe Operating Area

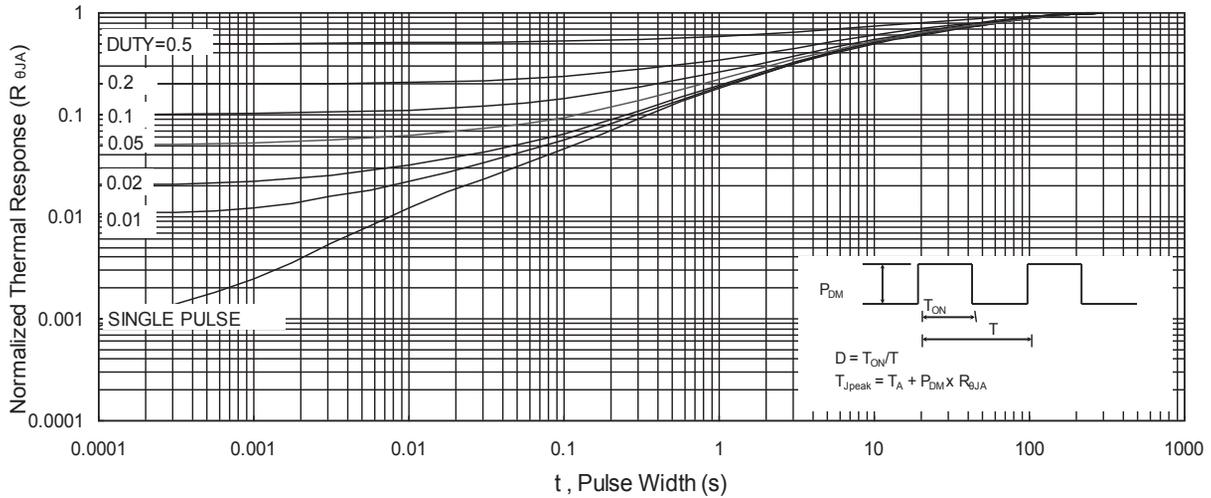


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

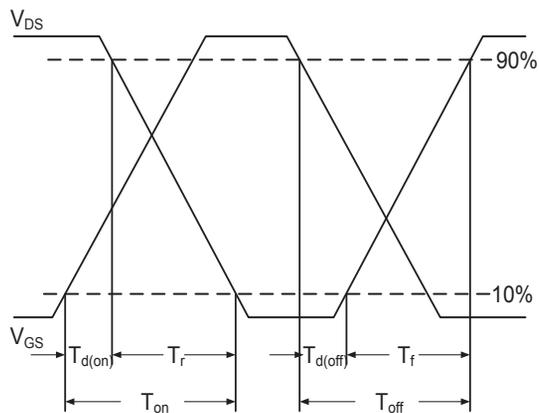


Fig.10 Switching Time Waveform

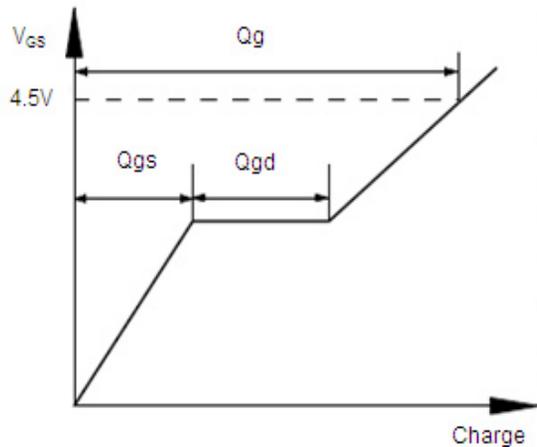


Fig.11 Gate Charge Waveform